

АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

«Технологии микросварки и пайки в изделиях электронной техники»

Направление подготовки 15.03.01 МАШИНОСТРОЕНИЕ

Профиль «Оборудование и технология сварочного производства»

Квалификация выпускника бакалавр

Нормативный период обучения 4 года / 4 года и 11 м.

Форма обучения очная / заочная

Год начала подготовки 2018

Цель изучения дисциплины:

- изучение теоретических основ и особенностей формирования микросварных и паяных соединений в изделиях электронной техники, технологии и оборудования.

Задачи изучения дисциплины:

- освоение способов микросварки и пайки;
- получение навыков разработки технологии микросварки и пайки на основе материала и конструкции изделия;
- изучение устройства, принципа работы и правил эксплуатации оборудования для микросварки и пайки.

Перечень формируемых компетенций:

ПК-14 - способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-17 - умение выбирать основные и вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении изделий машиностроения

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет